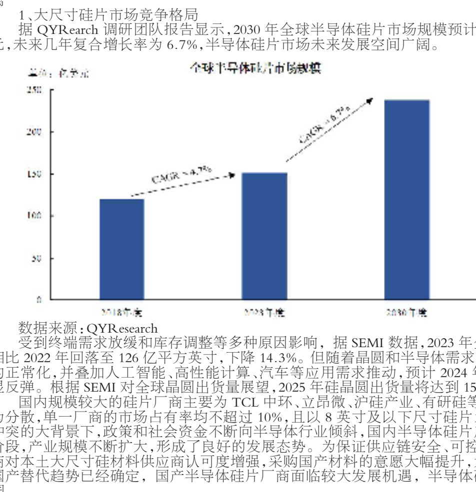
(上接C19版)
(三)年审会计师对存货跌价准备执行的具体审计程序
会计师执行了下列核查程序:
1、了解与存货跌价准备相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,并测试相关内部控制的运行有效性;
2、访谈管理层和财务人员,复核存货跌价准备计提的政策和程序;
3、对存货预计售价的选择进行复核,以判断管理层对预计售价估计的恰当性;
4、重新计算存货可变现净值,测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;
5、结合存货监盘程序,检查期末存货的数量及状况,针对库龄较长的存货进行重点检查,评价管理层是否已合理估计可变现净值,分析存货跌价准备计提的充分性;
6、查询同行业可比公司定期报告,检查与同行业可比公司相比是否存在异常,综合分析公司大幅计提存货跌价准备的原因及合理性。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、获取原材料、库存商品等存货收发存明细表,分析原材料、库存商品的波动原因;
2、复核计提库存商品、原材料相关存货跌价准备的计算过程,并分析"预计售价"取数合理性;
3、访谈公司财务负责人、生产负责人及销售负责人,了解大额计提存货跌价准备的具体原因;
4、查询同行业可比公司存货跌价计提政策、计提比例,分析公司存货跌价计提比例高于同行业可比公司具体原因;
5、取得公司就相关事项出具的说明。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司已补充披露计提库存商品、原材料相关存货跌价准备的计算过程,跌价准备计算公式中"预计售价"主要根据库存商品在手订单价格、库存商品期后的最近售价、客户询价单价、历史售价或其他相近产品的售价等综合判断,取数依据具有合理性。公司主要针对期末半导体大尺寸硅片计提较高存货跌价准备,存货跌价准备的计提符合《企业会计准则第1号——存货》及其应用指南和讲解的规定,不存在集中计提大额存货跌价准备的情形。
2、2023年末公司计提存货跌价准备3,482.62万元,存货跌价计提比例为19.47%,计提比例较高,主要系公司对期末半导体大尺寸硅片计提较高存货跌价准备所致。由于半导体大尺寸硅片业务产品尚处在认证阶段,对外销售的产品以价值较低的测试片为主,产品的销售价格无法覆盖单位成本,因此对半导体大尺寸硅片计提足额跌价准备。公司存货跌价准备计提比例高于境内同行业可比上市公司,主要系前述对库存商品中半导体大尺寸硅片计提跌价准备比例较高所致。第二部分 关于募投项目
问题5、关于8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目
年报显示,公司IPO募投项目"8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目"已达到预定可使用状态并结项,年产180万片所需要的生产设备已经全部订购完成,其中一期5万片/月的设备已达到规模化生产状态,二期订购的10万片/月的设备已经进场并安装调试。公司目前大尺寸硅片业务仍处于评估认证阶段,暂时未能产生相应的回报,2023年半导体大尺寸硅片毛利率-216.46%,发生停工损失3,878.90万元。
请公司:(1)结合大尺寸硅片市场竞争格局、公司最新评估认证进展、在手订单等情况,说明该业务的商业化前景,客户认证进展和订单导入缓慢的原因,相关产能规划是否与实际需求存在偏离;(2)说明公司半导体大尺寸硅片毛利率大额为负的原因及商业合理性,相关折旧摊销费用对公司报告期内业绩及未来业绩的影响,结合报告期内硅片生产线相关设备减值测试情况,说明相关产线资产情况、减值计提是否充分;(3)补充披露停工损失发生的原因、时间、期限、涉及产品线以及具体对应产品,相关主要资产是否足额计提减值准备,停工事项是否需履行信息披露义务,未来预计停工情况及对公司的影响;(4)说明公司为加快该项目实现效益已采取或拟采取的应对措施,并充分提示风险。
请年审会计师补充披露对公司固定资产减值测试、停工损失执行的具体审计程序,并发表意见。
一、公司回复
(一)结合大尺寸硅片市场竞争格局、公司最新评估认证进展、在手订单等情况,说明该业务的商业化前景,客户认证进展和订单导入缓慢的原因,相关产能规划是否与实际需求存在偏离
1、大尺寸硅片市场竞争格局
据QYRearch调研团队报告显示,2030年全球半导体硅片市场规模预计将达到237.5亿美元,未来几年复合增长率为6.7%,半导体硅片市场未来发展空间广阔。



数据来源:QYResearch
受到终端需求放缓和库存调整等多种原因影响,据SEMI数据,2023年全球硅晶圆出货量相比2022年回落至126亿平方英寸,下降14.3%。但随着晶圆和半导体需求的恢复和库存水平的正常化,并叠加人工智能、高性能计算、汽车等应用需求推动,预计2024年硅晶圆需求将明显反弹。根据SEMI对全球晶圆出货量展望,2025年硅晶圆出货量将达到153亿平方英寸。
国内规模较大的硅片厂商主要为TCL中环、立昂微、沪硅产业、有研硅等,市场竞争格局较为分散,单一厂商的市场占有率均不超过10%,且以8英寸及以下尺寸硅片为主。在国际贸易冲突的大背景下,政策和社会资金不断向半导体行业倾斜,国内半导体硅片产业迎来快速发展阶段,产业规模不断扩大,形成了良好的发展态势。为保证供应链安全、可控,下游集成电路厂商对本土大尺寸硅材料供应商认可度增强,采购国产材料的意愿大幅提升,大尺寸半导体硅片国产替代趋势已经确定,国产半导体硅片厂商面临较大发展机遇,半导体硅片的商业前景广阔。
2、公司最新评估认证进展
截至2024年3月31日,公司大尺寸硅片产品的最新评估认证进展如下:

客户名称	客户介绍	认证产品类型	认证阶段	预计认证获得时间	预计实现销售时间
中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	晶圆代工企业	测试片A	小批量生产	已小批量	已销售
		正片A	验证中	2025年6月	2025年10月
客户十五	晶圆代工企业	测试片B	小批量验证	2024年12月	2025年3月
		测试片C	准备送样	2024年12月	2025年3月
客户五	硅片制造企业	测试片D	批量生产	批量中	已销售
		测试片E	批量生产	批量中	已销售
客户十六	GaN-on-Si晶圆制造企业	正片B	验证中	2024年12月	2025年4月
长春长光圆辰微电子技术有限公司	图像传感器晶圆代工企业	正片C	批量生产	批量中	已销售
上海华虹宏力半导体制造有限公司	晶圆代工企业	测试片F	准备送样	2024年12月	2025年4月
客户十七	光通信芯片制造企业	测试片G	批量生产	批量中	已销售

目前公司正积极同国内多家主流晶圆代工厂商开展硅片测试片及正片的评估认证,并取得一定进展。
根据行业经验,下游芯片制造厂商对各类原材料的质量有着严苛的要求,对供应商的选择非常慎重。一般来说,半导体硅片企业的产品进入芯片制造厂商的供应链需要经历较长的时间,在下游客户正式认证通过前,需要首先通过测试片验证,认证过程重点关注经过工艺过程后直接的表征指标,该等指标需要通过几轮试验来确认是否满足工艺需求,一般需要3-6个月时间。在测试片验证通过后,产品片(即正片)的验证周期还需要9个月至1年时间,甚至更长。因此,从与下游芯片制造厂商建立联系到最终获得正式认证需要经历1-2年的时间。
此外,芯片制造厂商终端客户的产品更新速度也在一定程度上影响了新进硅片厂商的硅片认证和订单导入进度。出于产品稳定性的考虑,芯片制造厂商及终端客户在同一款产品上一般不会选择轻易更换上游硅片供应商,因此新进硅片厂商的认证和订单一般来自芯片制造厂商的新型产品。当终端客户产品更新速度越快时,芯片制造厂商新增的产品型号或种类越多,可供选择的上游硅片厂商的范围越广,新进硅片厂商获得认证和批量订单的机会越多。由于2023年消费电子等终端客户需求低迷,芯片制造厂商新增产品类型较少,新进硅片厂商取得认证和批量订单的机会较少。
综上,公司作为新进硅片厂商,受到芯片制造行业认证特性和半导体产业周期性下行影响,认证进展相对缓慢。
3、公司在手订单
截至2024年3月31日,公司大尺寸硅片的在手订单如下:

客户	在手订单金额(万元)
客户五	45.51
客户十七	30.00
中芯国际集成电路制造(天津)有限公司	3.25
合计	78.76

公司在手订单规模相对较小,订单导入相对缓慢,一方面系公司作为新进硅片厂商,受到芯片制造行业认证特性和半导体产业周期性下行影响,认证进展相对缓慢,拉长了客户订单导入的时间;另一方面系部分客户因存货管理需要,选择以月度作为下单周期,单次订单规模相对较小。
4、相关产能规划是否与实际需求存在偏离
尽管受到终端需求放缓和库存调整等多种原因影响,当前半导体行业处于调整期,但随着消费电子复苏和人工智能等新领域崛起,硅片需求将保持持续增长。SEMI在最新报告中预计,到2025年全球8英寸硅片需求将达到700万片/月,未来硅片市场空间广阔。
近年来,在政策和资本的强力支持下,我国半导体硅片产业快速发展,培育了一批骨干企业,突破了核心技术,自主保障能力显著提升,形成良好发展态势。国际贸易冲突频繁发生和全球地缘政治影响不断加剧,保障国内半导体产业链的安全和稳定至关重要,国内下游半导体厂商对国内半导体硅片供应商的认可度显著增强,产品认证和采购意愿大大提升,半导体硅片国产替代加速推进。
国内同行业可比公司针对8英寸硅片产能及扩产情况如下:

公司简称	8英寸已建产能	8英寸在建/计划扩产产能	硅片业务产品类型	抛光片产品构成	是否量产
TCL中环[注1]	87万片/月	13万片/月	硅抛光片、外延片	未披露	批量生产
沪硅产业[注2]	56.5万片/月	26万片/月	硅抛光片、外延片、SOI硅片	未披露	批量生产
立?微[注3]	27万片/月	25万片/月	硅抛光片、外延片	重掺占2/3,轻掺占1/3	批量生产
有研硅[注4]	10.5万片/月	5万片/月	硅抛光片	轻掺、重掺各占50%	批量生产
神工股份	15万片/月	/	轻掺低缺陷硅抛光片	均为轻掺	小批量生产

注1:TCL中环产能数据来自2022年半年度报告。
注2:沪硅产业产能数据来自2023年年度报告、子公司投资建设扩产项目公告等公开信息。
注3:立昂微产能数据来自2023年年度报告;抛光片产品构成信息来自2023年8月投资者关系活动记录表。
注4:有研硅产能数据来自招股说明书、2023年年度报告等公开信息,其中已建产能根据每片50.27平方英寸换算得到,抛光片产品构成信息来自2023年1月投资者关系活动记录表。
公司以生产技术门槛高,市场容量比较大的轻掺低缺陷抛光硅片为目标,致力于满足该产品的国内需求。轻掺低缺陷硅片主要用于低电压高性能电子产品,如手机等;而同行业可比公司在重掺硅抛光片领域投入较多产能,重掺硅片主要用于高电压产品,如充电器、家用电器、交通设备、通信设备等。低压产品的设计线宽更小,对硅片内在缺陷的控制要求更高,且硅片表面一般不做或只做很薄的外延层。轻掺低缺陷抛光硅片可以应用于8英寸相对高端的产品制程,拥有较高的附加价值。从全球市场8英寸硅片总需求上看,轻掺硅片占全部需求的70-80%;在12英寸硅片总需求中,轻掺硅片占比几近100%。
依靠在日本拥有20-30年轻掺低缺陷硅片生产经验的核心技术团队,持续深入8英寸无缺陷晶体的工艺开发,全面掌握了晶体内部缺陷的控制方法。公司8英寸轻掺低缺陷硅片对标行业龙头信越化学的同类产品,目前工艺窗口已经稳定,可以满足客户对晶体微缺陷等各项指标的苛刻要求,具备替代海外供应商向国内集成电路厂商供应高质量硅片的潜在实力。
相较于同行业可比公司,公司作为半导体硅片行业的新进入者,在产能建设规模和获得认证的产品数量上存在一定劣势。目前公司开发的8英寸半导体级硅单晶抛光片等产品已实现打通产线,部分产品已通过客户认证并实现小批量供货。尽管短期内公司产品需求存在一定压力,但随着认证工作逐步推进,管理层预期相关需求将迅速爬坡并给公司带来稳定的收入来源。
综上,由于大尺寸硅片行业市场长期向好、下游集成电路厂商对硅片国产替代的意愿持续提升、公司专注于轻掺低缺陷技术路线,长期来看,半导体硅片的市场需求能够覆盖公司大尺寸硅片产能,公司硅片产能规划与实际需求不存在重大偏离。
(二)说明公司半导体大尺寸硅片毛利率大额为负的原因及商业合理性,相关折旧摊销费用对公司报告期内业绩及未来业绩的影响,结合报告期内硅片生产线相关设备减值测试情况,说明相关产线资产情况、减值计提是否充分
1、半导体大尺寸硅片毛利率大额为负的原因及商业合理性
公司2023年度半导体大尺寸硅片业务毛利率为-216.46%,相较2022年度增加29.77个百分点,毛利率已有所上升,但半导体大尺寸硅片业务为公司新增业务,由于产品认证周期较长(产品认证周期具体请参见本题"(一)"之"2、公司最新评估认证进展"之回复),公司能够获得的批量订单规模有限,与达到规模经济尚存在较大距离,因此销售收入无法覆盖新增设备折旧等固定成本,导致半导体大尺寸硅片业务体现为负毛利,具有商业合理性。
2、相关折旧摊销费用对公司业绩的影响
2023年度,公司半导体大尺寸硅片营业收入、成本、毛利、毛利率情况如下表所示:
单位:万元

项目	2023年度
营业收入(A)	825.83
营业成本(B=C+D+G)	2,613.42
直接材料(C)	887.21
制造费用(D=E+F)	1,664.48
其中:折旧摊销费用(E)	939.84
其他制造费用(F)	724.64
直接人工(G)	61.73
毛利额(H=A-B)	-1,787.60
毛利率(I=H/A)	-216.46%
设备折旧摊销占营业成本比例	35.96%
设备折旧摊销对毛利率的影响(J=E/A)	113.81%

如上表所示,2023年度半导体大尺寸硅片成本结构中,折旧摊销费用为939.84万元,占营业成本比例为35.96%,对毛利率的影响为113.81%,相关折旧摊销费用对半导体大尺寸硅片业务相关业绩影响较大。
3、相关产线资产情况、减值计提是否充分
相关回复具体请参见本题回复之"(三)"之"2、相关主要资产是否足额计提减值准备"。
(三)补充披露停工损失发生的原因、时间、期限、涉及产品线以及具体对应产品,相关主要资产是否足额计提减值准备,停工事项是否需履行信息披露义务,未来预计停工情况及对公司的影响
1、停工损失发生的原因、时间、期限、涉及产品线以及具体对应产品
2023年度,公司业务受到半导体行业周期波动等综合因素影响,下游需求减弱,大直径硅材料销量出现下滑。此外,由于半导体大尺寸硅片业务产品认证周期较长,短期内能够获得的批量订单规模有限。因此,公司为减少固定能耗、增加经济效益、优化排产计划、准确核算各业务实现业绩情况,针对上述两项业务实施主动停工停产,具体情况如下表所示:

涉及产品线	具体对应产品	停工时间、期限、具体情况	2023年度停工损失金额(万元)
大直径硅材料	集成电路刻蚀用硅材料	2023年4月至12月,根据公司订单情况及生产计划,各月均有部分单晶炉及加工车间设备停工	制造费用:1,438.65 直接人工:233.39 合计:1,672.04
半导体大尺寸硅片	8英寸轻掺低缺陷硅片	2023年8月至12月,根据公司订单情况及生产计划,各月均有部分单晶生长设备及硅片加工工序设备停工	制造费用:2,149.75 直接人工:57.11 合计:2,206.86

2、相关主要资产是否足额计提减值准备
由于大直径硅材料及半导体大尺寸硅片产能利用率下降明显,公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对相关产线进行了评估,并出具了《锦州神工半导体股份有限公司因编制财务报告所涉及的固定资产与在建工程的可收回金额资产评估报告》(联信(证)评报字[2024]第Z0072号)。经评估,大直径硅材料产线未发生减值,半导体大尺寸硅片产线发生减值233.20万元,相关主要资产已足额计提减值准备。具体测算过程如下:
单位:万元

序号	科目名称	账面价值(a)	可收回金额(b)[注]	减值金额(c=a-b)
1	大直径硅材料产线	6,175.48	6,403.31	-
2	半导体大尺寸硅片产线	29,079.75	28,846.56	233.20
合计		29,079.75	28,846.56	233.20

注:可收回金额按照公允价值扣除处置费用金额与未来现金流量现值孰高值确定,其中未来现金流量系基于当前对未来市场的合理预估确定,未来随着下游市场需求周期性波动,存在订单不及预期风险。
上述评估关键参数过程如下:
(1)折现率的选择和计算
评估的折现率采用风险累加法确定,计算公式:折现率=无风险报酬率+风险报酬率,无风险报酬率是对资金时间价值的补偿,本次估值的无风险报酬率根据和讯网资讯查询的2023年12月31日国债到期收益率,取剩余期限为10年期以上国债的平均收益率确定,则本次无风险报酬率取3.52%。
风险报酬率包括设备的使用风险报酬率、经营风险报酬率及财务风险报酬率;截止评估基准日委估设备可以正常使用,但由于该生产线为新产线,部分设备尚在调试生产过程中,故其使用风险较高;由于委估资产为固定资产,其风险一般较低,但该生产设备要求其精度及其他准确度方面较高,故其经营风险中等;另外经评估人员对产权持有单位使用委估设备的历史财务数据分析,其财务状况中等、盈利能力较好,因此财务风险中等偏上,综上所述本次评估取风险报酬率为8.50%。
(2)年度终值的计算
年度终值是按企业年度终了产生现金流来计算现值的过程,而一般生产型企业会在年末产生较多的销售或回款,区别于一般的技术服务型企业,而本次评估按照该规律采用了年末折现的方式折现更合理谨慎。同样已考虑了与评估对象的特性和市场环境相匹配的结果。同行业其他企业同样存在这类年末销售或回款较多的情况,故采用年末折现是较合理的。
(3)重置成本的数据来源
市场询价:对于部分通用设备,根据其型号,匹配市场上现存仍在销售的设备的价格,获取相应经销商的报价,以此为定价依据。
价格指数调整:对于自制、定制的非标设备,无法在市场上获取同样或相似的设备,可根据国家统计局公布的"工业生产者出厂价格指数(上年=100)"进行调整。
处置费用中法律费用和附加税金分别根据以下法律依据或计费参考标准进行计算:拍卖费:《中华人民共和国拍卖法》规定:"拍卖人可以向买受人收取不超过成交价款5%的佣金。";评估费:《资产评估收费管理办法》(发改价格[2009]2914号)规定:"资产评估服务可实行计件收费、计时收费或两者相结合的收费方式。";产权交易手续费:各地产权交易中心的收费标准因交易类型和交易方式的不同而有所差异,一般情况下机电设备招投标交易服务费约为中标额的1‰。综上考虑,处置费用约为估值的1.5%~3.0%,属合理区间。
附加税金:根据相关税法规定计算。税金及附加为增值税的12%(其中:城市维护建设税为市区7%;教育费附加的征收税率为3%;地方教育附加的征收税率为2%),印花税为购置价的0.05%。
(4)收益期限的确定
以主要生产设备剩余使用寿命作为资产组收益年限。
(5)现金流量的确定
2024年至2032年,预计未来现金流量=资产组产生的利润中固定资产分成+折旧及摊销,2032年,预计未来现金流量=资产组产生的利润中固定资产分成+折旧及摊销+资产组残值,其中,设备资产组产生的利润中固定资产分成=净利润×分成率(25%)。
3、停工事项是否需履行信息披露义务
如前所述,停工事项主要系公司根据订单情况在生产计划方面实施的主动停工停产安排,不属于重大事故或使公司面临重大风险的情形。公司已在2023年半年报中单独核算停工损失费用,并在2023年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"2.收入和成本分析"中披露停工产生的原因及导致的停工损失具体金额,同时于"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"之"(五)财务风险"中提示相关风险。因此,公司针对停工事项已履行信息披露义务。
4、未来预计停工情况及对公司的影响
大直径硅材料方面,随着大直径硅材料海外需求回暖,2024年1季度公司产品销量及营业收入增长明显。公司预计大直径硅材料部分炉台主动停工于2024年9月结束,2024年4月至9月相关停工损失约320万元,均为停工相关的制造费用。
半导体大尺寸硅片方面,由于上述半导体大尺寸硅片业务产品认证周期较长,公司预计短期内停工因素将无法消除,2024年4月至12月相关停工损失约4,400万元,其中停工相关的制造费用4,231万元,直接人工169万元。
(四)说明公司为加快该项目实现效益已采取或拟采取的应对措施,并充分提示风险
为加快8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目实现效益,公司已采取及拟采取的措施包括:
1、调整募投项目建设节奏,稳步推进募集资金投入
公司于2021年12月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目"8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目"的预定可使用状态日期调整至2023年2月。公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目"8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目"的预定可使用状态日期调整至2024年2月。
前述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,已经过公司审慎研究论证并由董事会审议通过,项目进度变化是为了更好地实施募投项目,不会对公司的生产经营造成不利影响,有利于公司的长远发展。
公司结合实际经营发展需求进行调整,稳步推进募集资金投入,以最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。
2、持续优化募投项目管理,确保募投项目实施进度
为保证募投项目本次延期后能够顺利完成,公司采取了如下措施:(1)由专人负责该募投项目相关工作的协调与沟通,保质保量加快进度,确保不出现关键节点延后的情形;(2)指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方进行沟通与协调,配合做好各项工作,严格监督募投项目进展情况,确保募投项目按计划推进;(3)对设备安装及调试情况持续保持关注,对于可能拖延项目实施进度的情况及时向公司负责人汇报。
3、发挥技术及人才优势,加强募投项目人员支持
公司专注于生产技术门槛更高、市场容量更大的轻掺低缺陷抛光硅片,依靠在日本拥有20-30年轻掺低缺陷硅片生产经验的核心技术团队,持续深入8英寸无缺陷晶体的工艺开发,全面掌握了晶体内部缺陷的控制方法。同时,公司始终注重人才培养工作,通过自主培养和外部引进的方式,培育了一大批优秀的管理、技术人才,人才储备丰富。
为了保障研发项目工作的顺利开展,公司成立了专门的项目开发小组,保障在研项目的人员配置。项目开发小组的主要成员均具有多年的半导体行业技术开发、工艺研究和生产组织管理方面的经验,能够确保在研项目按计划实施。公司将持续通过内部培养和外部引进的方式完善技术团队、提高技术实力,为项目配备经验丰富的人员,利用技术及人才优势加强对项目的技术支持,从而加快项目的效益实现进程。
4、与供应商加强沟通合作,提高产品研发测试效率
对于募投项目的实施过程所需的设备、原材料及相关服务等,公司实施严格的供应商准入制度,设有合格供应商名单,并对该名单中的合格供应商服务进行定期考核和评定。在具体项目执行时,通常会综合考虑供应商产品或服务的稳定性、成本结构以及时间周期等因素,持续与供应商保持沟通,以确保相关研发测试工作的顺利开展,提高产品研发过程中的测试效率。
5、提前与关键客户沟通对接,加快产品验证过程
公司8英寸硅片产品的正片认证周期较长,预计需要9-18个月,但一旦相关认证工作完成,芯片制造厂商通常不会轻易更换供应商。公司在研发过程中即提前与客户进行沟通对接,工艺实验围绕重点客户的特殊硅片工艺要求推进,并充分借鉴现有产品研发和测试分析经验以缩短产品的认证周期。公司某款硅片已定期出货给某家日本客户,其各项指标已经满足了正片标准,另外公司8英寸测试片已经是国内数家集成电路制造厂商该材料的合格供应商。后续公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作,并积极开拓中国本土大尺寸硅片市场需求,力争通过主流集成电路制造厂商的正片评估并取得相应订单。
公司已在2023年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中充分提示风险:
"(四)经营风险
……
5、市场开拓及竞争风险
……公司大直径硅材料产品既有客户与硅零部件产品、半导体大尺寸硅片产品的目标客户并不重叠,公司拓展下游客户存在一定难度和不确定性;同时半导体8英寸轻掺低缺陷抛光硅片所在细分市场的市场集中度较高,新进入者面临的市场竞争较为激烈,公司募投项目实施存在市场竞争风险。如果公司不能成功开发半导体8英寸轻掺低缺陷抛光硅片或开发进度不及预期,则可能拉长前期技术投入的回报期或无法有效应对市场竞争,将会对公司未来经营业绩产生不利影响。"
(五)年审会计师对公司固定资产减值测试、停工损失执行的具体审计程序
会计师执行了下列核查程序:
1、了解及评价与固定资产减值测试、停工损失相关的内部控制设计的有效性,并测试关键控制执行的有效性;
2、访谈公司管理层、生产负责人,了解目前各类别产品产线的产能利用情况,了解资产的使用状况和磨损程度,获取并复核固定资产是否存在减值迹象所依据的资料;
3、对公司的固定资产进行监盘,实地勘察了相关固定资产,以了解资产是否存在长期闲置、技术落后、毁损报废等状况;
4、获取评估报告,对评估过程中的关键参数进行复核,评价评估报告中使用的减值测试方法和模型、减值测试关键参数及假设的恰当性;
5、访谈管理层了解停工损失发生的具体原因,询问并复核管理层停工损失的相关考虑及客观依据;
6、针对已经发生的停工损失,检查停工损失金额的计算过程、确定依据及合理性,以抽样的方式检查与停工损失确认相关的支持文件,结合准则规定复核会计处理的准确性。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、查阅公司募投项目的可行性研究报告,核查募投项目的投资进度规划;
2、查阅公司半导体大尺寸硅片在手订单明细及对应的合同;
3、访谈公司财务负责人、生产负责人、硅片事业部负责人,了解募投项目的实施情况;
4、查阅公司固定资产台账;
5、查阅公司募集资金使用情况统计表,抽查公司募集资金使用相关的交易合同、付款凭证及银行水单;
6、获取公司募投项目产品的销售数据以及与募投项目相关的行业资料和政策文件,分析募投项目对应业务的发展前景;
7、查阅停工涉及固定资产相关资产评估报告;
8、查阅公司年度报告披露的信息以及其他公开披露文件。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、受到芯片制造行业认证特性和半导体产业周期性下行影响,公司客户认证进展和订单导入相对较慢。由于大尺寸硅片行业市场长期向好、下游集成电路厂商对硅片国产替代的意愿持续提升、公司专注于轻掺低缺陷技术路线,长期来看,半导体硅片的市场需求能够覆盖公司大尺寸硅片产能,公司硅片产能规划与实际需求不存在重大偏离。
2、公司2023年度半导体大尺寸硅片业务毛利率为-216.46%,相较2022年度增加29.77个百分点,毛利率已有所上升,但半导体大尺寸硅片业务为公司新增业务,由于产品认证周期较长,与达到规模经济尚存在较大距离,因此销售收入无法覆盖新增设备折旧等固定成本,导致半导体大尺寸硅片业务体现为负毛利,具有商业合理性。2023年度半导体大尺寸硅片成本结构中,折旧摊销费用为939.84万元,占营业成本比例为35.96%,对毛利率的影响为113.81%,相关折旧摊销费用对半导体大尺寸硅片业务相关业绩影响较大。
3、停工事项主要系公司根据订单情况在生产计划方面实施的主动停工停产安排,不属于重大事故或使公司面临重大风险的情形,相关主要资产已足额计提减值准备。公司针对停工事项已在2023年半年报及年报中履行相应的信息披露义务。大直径硅材料方面,公司预计大直径硅材料主动停工于2024年9月结束,2024年4月至9月相关停工损失约320万元;半导体大尺寸硅片方面,公司预计短期内停工因素将无法消除且将面临一定业绩压力,2024年4月至12月相关停工损失约4,400万元。
4、公司为加快该项目实现效益已采取的应对措施充分,并已在2023年年度报告中充分提示募投项目的市场开拓及竞争风险。
第三部分 其他问题
问题6、关于制造费用
年报显示,公司2023年度营业成本13,491.82万元,同比下降52.54%。根据成本分析表,大直径硅材料的制造费用1,154.94万元,较上年度4,496.89万元同比下降74.32%。
请公司:补充披露大直径硅材料相关制造费用的主要内容,按制造费用明细内容披露属于变动成本或固定成本,并说明制造费用同比大幅下降的原因及合理性。
请年审会计师补充披露对公司制造费用执行的具体审计程序,并发表意见。
一、公司回复
(一)补充披露大直径硅材料相关制造费用的主要内容,按制造费用明细内容披露属于变动成本或固定成本
大直径硅材料相关制造费用的主要内容如下:

项目	变动/固定	金额(万元)		变动比例
		2023年度	2022年度	
折旧摊销	固定	597.82	1,116.86	-46.47%
财产保险费	固定	-	59.38	-100.00%
动力	固定+变动	459.14	2,828.73	-83.77%
加工维修费	变动	7.76	142.16	-94.54%
间接人工费	变动	86.77	286.97	-69.76%
其他	变动	3.45	62.79	-94.50%
合计		1,154.94	4,496.89	-74.32%

(二)说明制造费用同比大幅下降的原因及合理性
如上表,公司大直径硅材料产品制造费用下降74.32%,主要原因系2023年度公司大直径硅材料产品销量下降。
2023年度,公司大直径硅材料产品产量同比下滑95.59%,销售收入同比下滑82.45%。受前述影响,变动成本中,大直径硅材料产品所涉能源动力、加工维修费、间接人工等成本较上年大幅减少;固定成本中,财产保险2023年不再投保,部分资产在2023年已完成折旧摊销,以致折旧摊销费用减少。
综上所述,制造费用同比下降具有合理性。
(三)年审会计师对公司制造费用执行的具体审计程序
会计师执行了下列核查程序:
1、访谈公司管理层、生产负责人,了解制造费用主要项目的构成及变动情况;
2、获取制造费用明细表,分析制造费用项目变动的原因及合理性;
3、对制造费用项目进行检查,包括动力、折旧摊销费、加工维修费等主要费用项目,检查相关的发票、合同以及其他会计凭证,复核制造费用主要项目的准确性;
4、结合生产计划,对制造费用中的变动成本与固定成本项目波动原因进行分析,检查与能源消耗情况是否相符;
5、获取固定资产明细表、使用权资产明细表和长期待摊费用明细表,检查分摊至制造费用中的折旧摊销费是否一致;
6、对资产负债表日前后的制造费用执行截止性测试。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、查阅公司2023年度制造费用明细;
2、查阅固定资产明细表、使用权资产明细表和长期待摊费用明细表;
3、抽查制造费用相关的发票、合同以及其他会计凭证;
4、访谈公司总经理、财务负责人、销售负责人、生产负责人,了解公司制造费用的变动情况及原因;
5、查阅公司年度报告披露的信息以及其他公开披露文件。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为,公司2023年度制造费用同比下降的主要原因系大直径硅材料产品产销量下降,具有合理性。
问题7、关于其他应付款
年报显示,公司2023年末其他应付款余额1,153.98万元,较期初增长121.78%,主要系公司质保金增加所致。
请公司:补充披露其他应付款的具体内容、产生原因、交易对象及其与公司的关系、尚未收回或支付的原因及合理性,说明公司在营业收入大幅下降的同时质保金大幅增加的原因及合理性。
一、公司回复
(一)补充披露其他应付款的具体内容、产生原因、交易对象及其与公司的关系、尚未收回或支付的原因及合理性
公司其他应付款的具体内容、产生原因、交易对象及其与公司的关系、尚未收回或支付的原因具体如下:

交易对象	金额(万元)	具体内容	产生原因	与公司的关系	尚未支付原因
供应商一	515.50	晶体生长设备等	生产线扩建购买设备	无关联关系	合同约定自设备验收合格日起,一年质保期满且设备没有问题,需方在15个工作日内支付供方质保金,设备2023年验收合格,未到支付期。
供应商二	120.50	晶体生长设备	生产线扩建购买设备	无关联关系	买方签署验收合格单之日起12个月或设备首次运行后18个月(以任一先到为准),设备无质量问题,买方应支付给卖方剩余5%合同总价款即质保款,该金额未到支付期。
供应商三	68.20	清洗机	生产线扩建购买设备	无关联关系	验收合格后,一年内无任何质量问题,到期一个月内付清,该金额未到支付期。
供应商四	44.70	切割机	生产线扩建购买设备	无关联关系	自设备验收合格日起,一年质保期满且无任何问题,需方在15个工作日内支付给供方,该金额未到支付期。
中国电子系统工程第二建设有限公司	41.77	纯水、空压设备	硅片工程扩建	无关联关系	工程未验收,该金额未到支付期。
辽宁科诺环保设备有限公司	38.00	纯废水工程	生产线扩建工程	无关联关系	竣工验收合格后,待缺陷责任期满后,到期一个月内无息付清,该金额未到支付期。
浙江安洲新能源有限公司	29.40	晶体生长设备	生产线扩建购买设备	无关联关系	质保金在买方验收合格后30日内支付,该金额未到支付期。
丹东新东方晶体仪器有限公司	21.80	定向仪	生产线扩建购买设备	无关联关系	质保金在买方验收合格一年后30日内支付,该金额未到支付期。
供应商五	11.05	化学品供给系统	生产线扩建购买设备	无关联关系	质保金在买方验收合格一年后30日内支付,该金额未到支付期。
苏州赫瑞特电子专用设备科技有限公司	11.00	抛光机	生产线扩建购买设备	无关联关系	质保金在验收合格后一年内无任何质量问题,到期一个月内付清,该金额未到支付期。
合计	901.92	-	-	-	-
前十名金额占比	78.16%	-	-	-	-

基于上述,公司其他应付款的主要内容为设备和工程类的未付质保金,尚未支付的原因主要系款项未到支付期,具有合理性。
(二)说明公司在营业收入大幅下降的同时质保金大幅增加的原因及合理性
公司其他应付款中的质保金主要为设备和工程类的未付质保金,设备或工程均在以前年度采购,本期到货或验收,因此形成质保金,并且未到支付期限。公司本期营业收入下降的主要原因系行业周期下行影响,公司根据实际订单情况安排相关生产及销售工作,本期到货或验收的设备与工程主要系以前年度的设备及固定资产投资安排,与2023年度的产量及营业收入并无直接关系。
因此,公司在营业收入大幅下降的同时质保金大幅增加具有合理性。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、查阅公司2023年末的其他应付款明细;
2、查阅公司与供应商签订的设备及工程采购合同、发票、银行回单及记账凭证等资料;
3、访谈公司的总经理、销售部门负责人、采购部门负责人及生产部门负责人,了解其他应付款的具体内容及产生原因;
4、实地查看公司厂房,关注工程建设及设备安装情况;
5、取得公司就相关事项出具的说明。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司其他应付款的主要内容为设备和工程类的未付质保金,尚未支付的原因主要系未到支付期,具有合理性。
2、公司本期营业收入下降的主要原因系行业周期下行影响,公司根据实际订单情况安排相关生产及销售工作,本期到货或验收的设备与工程主要系以前年度的设备及固定资产投资安排,与2023年度的产量及营业收入并无直接关系。公司在营业收入大幅下降的同时质保金大幅增加具有合理性。
问题8、关于其他非流动资产
年报显示,公司2023年末其他非流动资产余额3,204.88万元,主要系预付长期资产购置款。
请公司:补充披露预付款的具体情况,包括但不限于交易对象、交易背景、购置标的及用途、对应在建工程项目、合同签订时间、预计交付时间等。
一、公司回复
公司2023年末预付款的具体情况如下:
单位:万元

供应商名称	合同金额	预付金额	预付时间	购置标的	用途	合同签订时间	预计交付时间	交易背景	对应在建工程项目
供应商六	7,938.50	2,341.55	2022.07	清洗机等设备	硅片生产	2022.06	2025.05	公司基于生产需求采购相关设备	半导体大尺寸硅片生产设备
北京精雕科技集团有限公司	304.95	188.60	2023.06、2023.08、2023.11	加工中心	硅零部件生产	2023.04	期后已到货		硅零部件生产设备
供应商一	2,056.00	154.20	2022.06	晶体生长设备	拉晶	2022.02	2025.06		大直径硅材料生产设备
天津市永顺昌达机电设备销售有限公司	139.80	115.46	2023.08、2023.09、2023.11	加工中心	硅零部件生产	2023.07	期后已到货		硅零部件生产设备
供应商七	JPY57,460,000.00	84.47(JPY17,238,000.00)	2023.10	加工中心	硅零部件生产	2023.09	期后已到货		硅零部件生产设备
供应商八	USD104,040.37	52.98(USD78,268.48)	2022.04、2022.08、2022.11	加工中心	硅零部件生产	2022.01	期后已到货		硅零部件生产设备
供应商九	49.80	44.82	2023.07、2023.10	加工中心	大直径硅材料加工	2023.06	期后已到货		大直径硅材料生产设备
特利尔环保科技(武汉)有限公司	149.00	44.70	2023.11	集中净化系统	硅零部件生产	2023.01	期后已到货		硅零部件生产设备
科意半导体设备(上海)有限公司	53.68	32.21	2022.08	硅片生产相关设备备件	硅片生产	2022.08	2026.03		半导体大尺寸硅片生产设备
上海硅德电子科技有限公司	587.00	32.01	2022.09、2023.12	硅片生产相关设备	硅片生产	2022.08	期后已到货		半导体大尺寸硅片生产设备
前十名金额占比	-	96.45%	-	-	-	-	-	-	-

半导体行业相关生产设备存在明显的技术壁垒,导致行业内设备供应商议价能力较强,因此公司多采用预付设备款的方式购买设备。由于半导体行业相关设备存在高度定制化的特点,设备从到货到可以正式投产所需调试期间较长,同时因阶段性部分地域交通受阻、项目实际建设情况等因素,综合导致部分设备交付时间较晚,预付供应商设备购置款期限较长,相关设备期后已陆续到货。
基于上述,公司预付款的形成系基于供应商与公司之间的合同安排,具有真实的交易背景及合理原因。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、查阅公司2023年末的预付款明细;
2、查阅公司与主要设备供应商签署的采购合同、发票、银行回单及记账凭证等资料;
3、访谈公司的总经理、采购部门负责人及生产负责人,了解公司预付款的具体情况;
4、实地查看公司厂房,关注设备的到货及安装情况;
5、取得公司就相关事项出具的说明。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为,公司预付款的形成系基于供应商与公司之间的合同安排,具有真实的交易背景及合理原因。
问题9、关于金融资产
年报显示,公司2023年末以公允价值计量的金融资产账面价值为4,587.25万元,其中主要内容为金融衍生工具,报告期内金融衍生工具的购买金额和出售/赎回金额分别为13,681.72万元和15,082.02万元。根据附注披露,以公允价值计量的金融资产期末公允价值采用第三层次公允价值计量,主要为衍生金融资产。根据审计报告,以公允价值计量的金融资产主要为债务工具投资。
请公司:(1)补充披露衍生金融工具的主要项目,2023年度发生大额购买、出售/赎回的商业背景及合理性;(2)补充披露衍生金融工具是否为公开市场交易,若否,说明交易对手方以及是否存在关联关系;(3)补充说明对衍生金融工具采用第三层次公允价值计量的具体方式,第一、二层次公允价值不可用的原因;(4)补充说明年报附注与审计报告就公允价值的披露存在不一致的原因。
请年审会计师补充说明对金融资产的确认和计量执行的具体审计程序,并发表意见。
一、公司回复
(一)补充披露衍生金融工具的主要项目,2023年度发生大额购买、出售/赎回的商业背景及合理性
公司2023年度交易性金融资产主要为购买的理财产品。公司账面存在较多尚未投入使用的资金,为充分发挥该部分资金的使用效率,实现资金的最大化收益,公司依据业务特点、资金状况以及经营发展需求,制定了详尽的资金预算和使用计划,秉承稳健、审慎的原则,利用部分暂时闲置的资金购买低风险银行理财产品及银行结构性存款产品,既考虑了资金的安全性,又兼顾了收益的稳定性,确保了资金的有效利用。
因此,公司2023年度发生大额购买、出售/赎回具有合理原因。
(二)补充披露衍生金融工具是否为公开市场交易,若否,说明交易对手方以及是否存在关联关系
公司购买或赎回的理财产品为非公开市场交易,交易对手方为招商银行、工商银行等商业银行及中金证券,公司与其均不存在关联关系。
(三)补充说明对衍生金融工具采用第三层次公允价值计量的具体方式,第一、二层次公允价值不可用的原因
根据准则对公允价值计量和披露的要求,公司将估值技术所使用的输入值分为三个层次,并优先使用活跃市场上相同资产或负债未经调整的报价即第一层次输入值,最后使用不可观察输入值即第三层次输入值。
第一层次输入值是公司在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产的不可观察输入值。根据要求,只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
公司期末交易性金融资产余额均为购买的理财产品。该部分理财产品没有活跃市场报价,其公允价值是参照交易对手金融机构提供的资产负债表日的资产净值进行计量,重大不可观察输入值为净资产,其公允价值随资产净值同向变化。
由于历史实际收益率与预期收益率相当,公司采用产品预期收益率及收益期对交易性金融资产中的理财产品进行公允价值计量。
资产负债表日,对于未到期理财产品,公司根据理财产品说明书等约定的预计收益率区间,基于谨慎性原则,选取较低的收益率测算理财产品的公允价值,较上期末的公允价值变动计入本期利润表的公允价值变动收益。理财产品到期赎回时,公司根据赎回理财产品实际取得的收益,扣减前期已确认的公允价值变动收益后的金额,确认投资收益。
基于上述,公司在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价,且相关可观察输入值无法取得,因此导致第一、二层次公允价值不可用,因此采用第三层次公允价值计量。
经查询公开信息,部分上市公司将同类理财产品同样选用第三层次公允价值进行计量,公司选用第三层次公允价值进行计量具有合理性。
(四)补充说明年报附注与审计报告就公允价值的披露存在不一致的原因
公司期末交易性金融资产均为购买的理财产品,具体构成如下:
单位:万元

序号	理财机构	委托理财类型	本金	公允价值变动	期末余额
1	中金证券	券商理财产品	1,000.00	0.65	1,000.65
2	招商银行	银行理财产品	850.00	5.76	855.76
3	招商银行	银行理财产品	1,400.00	0.96	1,400.96
4	招商银行	银行理财产品	399.70	0.03	399.73
5	工商银行上海分行	银行理财产品	400.00	6.59	406.59
合计			4,049.70	14.00	4,063.70

公司年报附注中将其披露为衍生金融工具,审计报告中将其披露为债务工具投资,存在披露不一致的情形,主要为公司财务人员对金融工具的相关分类理解存在差异所致。根据公开信息显示,部分上市公司在交易性金融资产下的债务工具投资项目披露同类理财产品的公允价值计量,亦有部分上市公司在交易性金融资产下的衍生金融工具项目下披露同类理财产品的公允价值计量。
上述不一致情形不影响公司期末持有的理财产品的公允价值计量,仅为公司与审计机构在披露交易性金融资产具体类别上的差异,不会对投资者的相关决策产生重大影响。公司已根据相关金融工具准则的具体要求,逐项判断金融工具的相关类别,并在2023年年度报告中进行更正。
同时,公司将持续加强对财务人员的培训,深入学习《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关法律法规,加强相关人员合规披露意识,杜绝上述披露不规范的情形再次发生。
(五)年审会计师对金融资产的确认和计量执行的具体审计程序
会计师执行了下列核查程序:
1、取得了公司签订的理财产品购买协议、产品说明书,检查协议内容是否符合普遍的商业规律,金融资产是否为公开市场交易,是否存在利益输送的特殊条款;
2、对金融资产执行了函证程序,并取得了回函,核实了不同金融资产余额以及受限情况;
3、取得了公司金融产品台账并与公司账面记录进行核对,在此基础上测算了金融资产的收益情况;
4、抽查了公司购买和赎回金融产品的银行回单,核实了购买和赎回金融产品的资金流向。
二、保荐机构核查情况
(一)核查程序
保荐机构执行了下列核查程序:
1、查阅公司签订的理财产品购买协议、产品说明书等资料;
2、复核会计师对金融资产执行的函证程序;
3、查阅公司金融产品台账并与公司账面记录进行核对;
4、抽查公司购买和赎回金融产品的银行回单、记账凭证等资料;
5、访谈公司的总经理、财务负责人,了解公司交易性金融资产的构成;
6、取得公司就相关事项出具的说明。
(二)核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、公司2023年度交易性金融资产主要为公司为提高资金使用效率而购买的理财产品,2023年度发生大额购买、出售/赎回具有合理性。
2、公司购买或赎回的理财产品为非公开市场交易,交易对手方为招商银行、工商银行等商业银行及中金证券,公司与其均不存在关联关系。
3、公司选用第三层次公允价值进行计量具有合理性,公司金融资产及公允价值变动计量可靠、确认依据充分合理。
4、公司年报附注中将其披露为衍生金融工具,审计报告中将其披露为债务工具投资,存在披露不一致的情形,主要为公司财务人员对金融工具的相关分类理解存在差异所致。上述不一致情形不影响公司期末持有的理财产品的公允价值计量,仅为公司与审计机构在披露交易性金融资产具体类别上的差异,不会对投资者的相关决策产生重大影响。公司已根据相关金融工具准则的具体要求,逐项判断金融工具的相关类别,并在2023年年度报告中进行更正。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2024-026

锦州神工半导体股份有限公司关于2023年年度报告的补充及更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月30日披露了《锦州神工半导体股份有限公司2023年年度报告》(以下简称"2023年年度报告")。经事后审核及公司自查,发现年报部分内容需要补充及更正。本次更正不涉及对财务报表的调整,不会对公司2023年度财务状况及经营成果产生影响。
一、补充情况
(一)"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"之"(四)经营风险"进行了补充披露,具体如下:
"5.市场开拓及竞争风险
……
为加快8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目实现效益,公司已采取及拟采取的措施包括:
1)调整募投项目建设节奏,稳步推进募集资金投入
公司于2021年12月27日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目"8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目"的预定可使用状态日期调整至2023年2月。公司于2023年2月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目"8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目"的预定可使用状态日期调整至2024年2月。
前述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,已经过公司审慎研究论证并由董事会审议通过,项目进度变化是为了更好地实施募投项目,不会对公司的生产经营造成不利影响,有利于公司的长远发展。
公司结合实际经营发展需求进行调整,稳步推进募集资金投入,以最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。
2)持续优化募投项目管理,确保募投项目实施进度
为保证募投项目本次延期后能够顺利完成,公司采取了如下措施:(1)由专人负责该募投项目相关工作的协调与沟通,保质保量加快进度,确保不出现关键节点延后的情形;(2)指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方进行沟通与协调,配合做好各项工作,严格监督募投项目进展情况,确保募投项目按计划推进;(3)对设备安装及调试情况持续保持关注,对于可能拖延项目实施进度的情况及时向公司负责人汇报。
3)发挥技术及人才优势,加强募投项目人员支持
公司专注于生产技术门槛更高、市场容量更大的轻掺低缺陷抛光硅片,依靠在日本拥有20-30年轻掺低缺陷硅片生产经验的核心技术团队,持续深入8英寸无缺陷晶体的工艺开发,全面掌握了晶体内部缺陷的控制方法。同时,公司始终注重人才培养工作,通过自主培养和外部引进的方式,培育了一大批优秀的管理、技术人才,人才储备丰富。
为了保障研发项目工作的顺利开展,公司成立了专门的项目开发小组,保障在研项目的人员配置。项目开发小组的主要成员均具有多年的半导体行业技术开发、工艺研究和生产组织管理方面的经验,能够确保在研项目按计划实施。公司将持续通过内部培养和外部引进的方式完善技术团队、提高技术实力,为项目配备经验丰富的人员,利用技术及人才优势加强对项目的技术支持,从而加快项目的效益实现进程。
4)与供应商加强沟通合作,提高产品研发测试效率
对于募投项目的实施过程所需的设备、原材料及相关服务等,公司实施严格的供应商准入制度,设有合格供应商名单,并对该名单中的合格供应商服务进行定期考核和评定。在具体项目执行时,通常会综合考虑供应商产品或服务的稳定性、成本结构以及时间周期等因素,持续与供应商保持沟通,以确保相关研发测试工作的顺利开展,提高产品研发过程中的测试效率。
5)提前与关键客户沟通对接,加快产品验证过程
公司8英寸硅片产品的正片认证周期较长,预计需要9-18个月,但一旦相关认证工作完成,芯片制造厂商通常不会轻易更换供应商。公司在研发过程中即提前与客户进行沟通对接,工艺实验围绕重点客户的特殊硅片工艺要求推进,并充分借鉴现有产品研发和测试分析经验以缩短产品的认证周期。公司某款硅片已定期出货给某家日本客户,其各项指标已经满足了正片标准,另外公司8英寸测试片已经是国内数家集成电路制造厂商该材料的合格供应商。后续公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作,并积极开拓中国本土大尺寸硅片市场需求,力争通过主流集成电路制造厂商的正片评估并取得相应订单。
6.毛利率下滑的风险
近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化,未来随着公司刻蚀用多晶硅材料销售规模的扩大以及募投项目建成后新增设备折旧的计提,若公司不能持续推出具有市场竞争力的优质产品,并通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本,则可能面临大直径硅材料业务毛利率进一步下滑的风险。
公司已采取或拟采取的应对措施包括:
1)积极开拓市场,加强客户开发与维护,持续拓展国外国内营销网络
公司持续挖掘市场深度,维护巩固现有客户的合作关系,公司产品主要销往日本、韩国等国家和地区。凭借先进的生产制造技术、高效的产品供应体系以及良好的综合管理能力,公司与客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司已成功进入国际先进半导体材料产业链体系,在行业内拥有了一定的知名度。未来,公司将利用先发优势,凭借过往合作的良好关系和公司产品质量口碑,通过完善客户管理、提升客户服务水平等方式增强客户粘性,持续提高和现有客户的合作紧密程度,争取现有客户的持续性业务机会,并努力扩大业务合作规模。
公司拓宽市场广度,积极开拓新客户。在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时,公司尤其注重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触。未来,公司将继续以客户为中心,在原有营销体系的基础上,通过扩大和完善国内销售及售后服务网络建设,加强国内市场盲区覆盖,抓住国内半导体行业发展的机遇,凭借优质的产品性能和服务能力,积极拓展和培育符合公司整体战略方向的具有市场影响力的国内客户,扩大国内市场销售的份额。
2)加大技术研发投入,优化产品结构,保持产品竞争力
公司以行业技术发展趋势及客户核心需求为导向,持续培养和引进高素质研发技术人才,加大研发投入,储备新技术、新工艺,加强研发体系和能力建设,使公司保持高效的持续创新能力。一方面,公司将持续强化现有核心产品的技术优势,保持现有产品的核心竞争力,并重点加强为客户提供定制化产品与解决方案的能力;另一方面,公司将加大对现有产品横向及纵向产品线的研发投入,致力于实现在半导体级单晶硅材料领域核心技术的突破,持续增强公司的行业竞争力和市场地位。
3)加强供应链管理,降低采购成本
公司持续提升对原材料市场进行研究和分析能力,密切关注原材料行情信息,根据市场价格波动情况及预期未来走势,结合公司安全库存、未来订单和排产计划,合理调整主要原材料备货量,尽可能降低原材料的采购成本。同时,公司将不断加强供应商管理,在与供应商保持长期稳定的合作关系的同时,积极开拓新的优质供应商,提高公司采购议价能力,在保证原材料品质的前提下,通过供应商询价与比价方式选择最有利的采购价格,不断降低采购成本。
4)强化生产管理水平,提高生产效率
在材料成本方面,公司将继续优化生产工艺流程或提升生产线自动化水平等方式,以进一步降低生产过程的材料损耗、提升产品良率和产品一致性;在人工成本方面,公司将通过优化生产安排、提升生产自动化水平等方式,强化公司生产现场管理水平,进一步提高一线生产效率,降低生产成本。"
(二)"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"之"(五)财务风险"进行了补充披露,具体如下:
"报告期末,公司应收账款余额为6,032.49万元,坏账准备余额为813.52万元。公司应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关,受半导体行业下行周期影响,公司下游客户销量减少,回款压力增加,出现阶段性短期逾期的情况。若未来主要客户经营情况发生变动,公司可能面临应收账款无法收回的风险,将对公司财务状况产生不利影响。
针对应收账款的逾期风险,公司采取多项措施加大逾期款项的清理力度,同时逐步完善应收账款的内部控制和规范回款、催款的管理。公司采取的主要措施包括:
(1)从公司层面加强对应收账款管理工作的重视,将应收账款管理作为公司级的重点工作事项,加强对回款工作的考核,将回款作为销售部门及员工的重点工作目标和指标;
(2)提高对逾期应收账款跟踪的频率,公司财务和销售等相关部门每周召开应收账款回款例会,分析客户回款情况和存在的风险,对重点客户和逾期项目重点监测和跟踪;
(3)形成从发生、分析、例会跟踪到监督、考核的完整闭环应收账款管理机制。
未来公司将进一步完善应收账款内部控制管理,从信用政策、回款跟踪分析、回款催收、考核和激励等全过程提升应收账款管理工作的质量,完善应收账款内部控制活动的设计、加强控制活动的执行等方面降低应收账款逾期的风险。"
二、更正情况
(一)"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(五)投资状况分析"之"3.以公允价值计量的金融资产"进行更正。
更正前:
单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
金融衍生工具	55,016,667.22	121,681.44			136,817,225.00	150,820,214.00	-498,368.53	40,636,991.13
其他	5,625,319.86		25,409.80				-415,189.04	5,235,540.62
合计	60,641,987.08	121,681.44	25,409.80		136,817,225.00	150,820,214.00	-913,557.57	45,872,531.75

更正后:
单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	55,016,667.22	121,681.44			136,817,225.00	150,820,214.00	-498,368.53	40,636,991.13
其他	5,625,319.86		25,409.80				-415,189.04	5,235,540.62
合计	60,641,987.08	121,681.44	25,409.80		136,817,225.00	150,820,214.00	-913,557.57	45,872,531.75

(二)"第十节 财务报告"之"十三、公允价值的披露"之"1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"进行更正。
更正前:
单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(一)交易性金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)应收款项融资		120,822.26		120,822.26
(三)其他债权投资				
(四)其他权益工具投资			5,114,718.36	5,114,718.36
(五)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

更正后:
单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(一)交易性金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
(1)债务工具投资			40,636,991.13	40,636,991.13
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)应收款项融资		120,822.26		120,822.26
(三)其他债权投资				
(四)其他权益工具投资			5,114,718.36	5,114,718.36
(五)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

二、其他说明
除上述更正内容外,《2023年年度报告》其他内容保持不变,更正后的《2023年年度报告》将与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2024年5月11日